

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-21

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（ <u>策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	中信建投证券、汇添富基金、华西证券、中欧基金、盘京投资、鼎赛资本、博时基金、鼎和财产保险、利多星（上海）、海南硕丰私募基金、海南翎展私募基金、诺安基金、生命保险资产、国投瑞银基金、宝盈基金、红筹投资、红杉中国、华泰证券自营、君瓴投资、新华资产、东方阿尔法基金、融通基金、华安财保资产、中银基金、江南基金、红土创新基金、南方基金、深圳量度资本投资、建信基金、中港融鑫资产、摩根士丹利基金、深圳市招信投资、华泰保兴基金、上海古木投资、大成基金、爱建证券、南昌产投投资基金、东方基金、四川金舵投资、深圳市前海万方达资产、华宝基金、泸州老窖资本、富荣基金、深圳前海华强金融、华西金智投资、深圳民沣资产、上海胤胜资产、广东正圆私募基金、先锋基金、信达澳亚基金、汇安基金、深圳市高益私募证券基金、深圳市恒邦兆丰私募证券基金、上海思晔投资、深圳市承泽资产、建信理财、深圳道朴私募证券基金、兴证全球基金、深圳市辰禾投资、深圳市鑫融长弘投资、广东吉翱私募基金、前海开源基金、国盛融创投资、北京博星证券投资、深圳市羽翰私募证券基金、深圳市瀚鑫私募证券投资基金、鹏华基金、天弘基金、川华私募、深圳前海钰锦证券基金、立白投资、万联证券、国盛证券、长城基金、国金证券、平安基金、银河证券、国信证券
上市公司 接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2026 年 9 月 17 日-9 月 18 日
地点	公司会议室、华西证券策略会
形式	实地调研

投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍 2026 年上半年公司经营业绩情况。 2026 年上半年，公司实现营业总收入 152.96 亿元，同比增长 46.33%；归属于上市公司股东的净利润 22.51 亿元，同比增长 65.55%。 报告期内，公司把握 AI 算力基础设施持续投入、产品迭代升级带来的行业增长机遇，有线通信、数据中心领域收入同比实现明显增长；封装基板业务受益于计算、存储领域需求快速放量，订单收入显著增加；电子装联把握数据中心领域需求增长机会，数据中心领域的订单结构明显优化，营收和利润实现增长。同时公司通过持续强化工艺技术能力、推进产能建设、优化产品结构、提升运营效率，产能利用率稳步提升，叠加广州工厂产能爬坡进展顺利，助益利润实现同比增长。 Q2、请介绍 2026 年上半年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。 2026 年上半年，公司 PCB 业务实现主营业务收入 85.52 亿元，同比增长 36.32%，占公司营业总收入的 55.91%；毛利率 36.85%，同比增加 2.43 个百分点。 报告期内，公司继续把握 AI 算力需求增长带来的发展机遇，光模块、交换机、AI 服务器及相关配套产品需求释放，订单收入同比实现大幅增长。在上述因素的带动下，PCB 业务营收规模增加、产品结构优化，带动 PCB 业务毛利率上行。 Q3、请介绍 2026 年上半年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。 2026 年上半年，公司封装基板业务实现主营业务收入 36.67 亿元，同比增长 110.76%，占公司营业总收入的 23.97%；毛利率 31.35%，同比增加 16.20 个百分点。 报告期内，封装基板业务把握存储、计算、电源管理方面的发展机遇，存储类基板收入占比同比大幅提升，处理器芯片类基板需求快速增长，PMIC 订单收入释放，叠加广州工厂爬坡顺利，产能利用率提升，助力封装基板业务毛利率大幅改善。 Q4、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。 公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，充分发挥电子互联产品技术平
---------------------------	---

	台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。 Q5、请介绍 PCB 工厂产能建设情况。 公司 PCB 业务生产基地分布在深圳、无锡、南通及泰国，其中泰国工厂与南通四期项目已于 2025 年下半年顺利连线投产，目前正处于产能爬坡阶段；无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目处于建设中，建设期为 1 年。此外，公司也在持续开展技改，并将根据市场情况，适时推进新项目论证和建设。 Q6、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。 2026 年上半年，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，BT 类封装基板产能爬坡稳步推进；FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进，同时公司成功推动高端产品在多个客户处实现规模化量产，带动广州工厂产能加速爬坡。 Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。 公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年上半年，原材料价格继续受到大宗商品价格变化的影响。一方面黄金、铜、锡等大宗商品价格大幅波动，另一方面上游覆铜板玻纤电子布、铜箔等关键物料供不应求态势持续加剧，导致相关成本大幅上涨，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。 Q8、请介绍公司 2026 年上半年资本开支的方向。 2026 年上半年，公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
------	---